

1. Record Nr.	UNICAMPANIASUN0108306
Autore	Qu, Shichun
Titolo	Wafer-Level Chip-Scale Packaging : Analog and Power Semiconductor Applications / Shichun Qu, Yong Liu
Pubbl/distr/stampa	xvii, 322 p. ; 24 cm
ISBN	8-1-4939-1555-2
Edizione	[New York : Springer, 2015]
Descrizione fisica	Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone)	Liu, Yong
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia